



美光公司运用业界最先进的工艺推出新款NAND与低功率DRAM多芯片封装产品

Boise, Idaho, 2009年11月3日 – 衣阿华州博伊西--(美国商业资讯)--美光科技股份有限公司 (Micron Technology, Inc., 纽约证券交易所: MU) 今天宣布, 该公司将业界一流的34纳米4Gb单层单元NAND闪存与50纳米2Gb LPDDR相结合, 生产出了市场上最先进的NAND-LPDDR多芯片封装组合产品。美光新推出的4Gb NAND-2Gb LPDDR多芯片封装产品以智能手机、个人媒体播放器和新兴的移动互联网设备为应用目标。较小的外形尺寸、低成本和节能是这类应用的核心特色。

美光公司目前向客户推出4Gb NAND-2Gb LPDDR多芯片封装试用产品, 预计于2010年初投入量产。4Gb NAND-2Gb LPDDR组合产品以当今移动设备的主流密度规格为目标, 不过, 随着移动市场集成更多复杂的多媒体功能, 美光还可灵活地支持更高密度, 最高可提供8Gb NAND和8Gb LPDDR。请访问[美光创新博客](#), 详细了解美光多芯片封装新产品, 以及业内专业人士对不断变化的移动内存产业格局的独到观点。

美光移动内存营销总监Eric Spanneut说, “依靠封装中使用的34纳米4Gb NAND和50纳米2Gb LPDDR单片晶片, 我们为客户带来了NAND型多芯片封装领域最先进的解决方案。多功能移动设备已成为行业的发展趋势, 在此背景下, 我们把业界领先的NAND和DRAM工艺结合起来, 利用我们新一代的多芯片封装技术实现集成, 从而可以轻松地满足市场向高密度NAND设备发展过程中的需求。”

除了多芯片封装产品组合之外, 美光还为移动市场提供一系列内存产品, 包括单独的NAND和LPDRAM部件、e-MMC

4.4管理型NAND解决方案和NANDcode软件。美光与包括操作系统以及芯片提供商在内的整个移动价值链密切合作, 从而取得独特的市场地位, 可为客户提供种类丰富的工程支持和解决方案组合, 以满足他们具体的设计需求。

相关链接

您还可通过其他途径了解美光最新新闻:

- 美光创新博客: www.micronblogs.com
- 美光Twitter: <http://twitter.com/microntechnews>
- 美光新闻室: www.micron.com/media

关于美光公司

美光科技股份有限公司 (Micron Technology, Inc.) 是高级半导体解决方案的全球领先供应商之一。通过全球化的运营, 美光公司制造并向市场推出DRAM、NAND闪存、其他半导体组件以及存储器模块, 用于前沿计算、消费品、网络和移动便携产品。美光公

司普通股代码为MU，在纽约证券交易所（NYSE）交易。如需了解美光科技有限公司的详细情况，请访问：www.micron.com。

Micron（美光）和美光环绕标志是美光科技股份有限公司的商标。所有其他商标属其各自所有人财产。

本新闻稿包含有关美光新MCP产品组合生产的前瞻性陈述。实际情况或结果可能与这些前瞻性陈述所含内容产生显著差异。请参考美光公司在并表基础上不时向美国证券交易委员会呈报的文件，特别是公司最新的10-K表和10-

Q表。这些文件含有并明确了可能导致公司在合并报表基础上的实际业绩与我们的前瞻性陈述中所含内容产生重大差异的重要因素（参见“**已知因素**”章节）。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的期望是合理的，但我们不能对未来业绩、活动水平、表现或成绩做出保证。

CONTACT:

Kirstin Bordner
Micron Technology, Inc.
208-368-5487
kbordner@micron.com